Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт институт

Межинститутская базовая кафедра «Прикладная физика и космические технологии» кафедра

УТ	ЪЕРЖДА	Ю	
Заведующий кафедрой			
		А. В. Кузовниког	
	подпись	инициалы, фамилия	
‹ ‹	>>	2024Γ	

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

«Разработка новой технологии определения характеристик керамических плат низкотемпературного отжига»

тема

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

код и наименование направления

15.04.05.02 «Технологии производства космических аппаратов»

код и наименование магистерской программы

Руководитель	подпись, дата	доцент МБК ПФиКТ канд. физ-мат. наук должность, ученая степень	А.А. Хвалько инициалы, фамилия
Выпускник	подпись, дата	репунний инучнер-	А.А. Гераськина инициалы, фамилия
Рецензен	подпись, дата	ведущий инженер- конструктор отдела 640 <u>АО «РЕШЕТНЁВ»</u> должность, ученая степень профессор МБК ПФиКТ	В.Б. Гарданов инициалы, фамилия
Нормоконтролёр	подпись, дата	д-р техн. наук, доцент должность, ученая степень	В.Е.Чеботарев инициалы, фамилия

Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт институт

Межинститутская базовая кафедра «Прикладная физика и космические технологии» кафедра

У]	TBEP:	ЖДА	Ю	
3aı	ведую	ощий	кафедрой	
			<u> А.В. Куз</u>	овников
	под	пись	инициалы,	фамилия
‹ ‹	25	>>	апреля	2024 г

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

в форме магистерской диссертации

Студенту	Гераські	<u>иной Але</u> фамилия, им	_	Андрее	евне
Группа	MT22-04M Han	равление (специаль	ность) _	15.04.05
«Конструкт	горско-технологическо	е обес	спечение	мац	, ,
производст	<u> </u>	наименован	ие		
	ускной квалификацион ия характеристик кера				
Утвержден	а приказом по универс	итету №	8094/c	от	14.05.24
кафедры	инициалы, фам	изика 1 илия, должно	И КОСІ ость, ученое	мические звание и м	е технологии: есто работы
	данные для ВКР: <u>в ра</u> ия характеристик керам				
технологич керамическ для произ разработка тепловых и LTCC; методики определени коммутаци	разделов ВКР: введенностей кой основах; печатная водства модулей на образцов кармически механических свойствыбор материала; проведения испытаме тепловых и мехонных плат; прочнодность и теплоемкость	коммутац плата; сра основе L' их комму гв; произво разрабо аний; хар анических	монных авнительна ТСС; при пационны одители мотка ком ствойствоффициен	плат н ный анал именяем х плат атериало серамиче ики; э в образа	а эпоксидной плиз; оборудование оборудование для определения в для технология ских образцов кармических
Перечень материал.	графического матери	ала: през	ентация	PowerPo	oint, раздаточный
Руководите	ель ВКР	подпис	СР		А.А. Хвалько ициалы и фамилия
Задание пр	инял к исполнению	подпис	СР		А.А. Гераськина пы и фамилия студента
					20 -

РЕФЕРАТ

Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) по теме «Разработка новой технологии определения характеристик керамических плат низкотемпературного отжига» содержит 69 страниц текстового документа, 20 использованных источников.

ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА, ТЕХНОЛОГИЯ, НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ ОТЖИГ, КЕРАМИКА, ХАРАКТЕРИСТИКИ, АНАЛИЗ.

Целью ВКР является разработка новой технологии определения характеристик керамических плат низкотемпературного отжига.

Задачи ВКР:

- выполнить анализ предметной области, и патентные исследования по теме характеристик керамических плат, проанализировать исходные данные материала;
- разработать технологию определения характеристик керамических плат низкотемпературного отжига, определение только механической прочности;
- провести сравнение характеристик, полученных новым методом и исходных данных.

Критерий оценки результата: теплопроводность, удельная теплоемкость, плотность, коэффициент Пуассона, предел прочности.

Практическая значимость: внедрение технологий, улучшит разработку изделий из керамических плат. Включая изделия ракетно-космической отросли.

В результате ВКР была разработана новая технология определения характеристик керамических плат низкотемпературного отжига.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Сравнительный анализ конструктивных и технологических	
особенностей коммутационных плат на эпоксидной и керамической	
основах	7
1.1 Печатная плата	7
1.2 Сравнительный анализ	18
1.2.1 Печатная плата на эпоксидной основе	19
1.2.2 Печатная плата из керамики	22
1.3 Оборудование для производства модулей на основе LTCC	30
1.4 Применяемое оборудование	31
Выводы раздела 1	39
2 Разработка образцов кармических коммутационных плат для	
определения тепловых и механических свойств	40
2.1 Производители материалов для технологии LTCC	40
2.2 Выбор материала	42
2.3 Разработка керамических образцов	42
2.4 Методики проведения испытаний	47
2.5 Характеристики	52
Выводы раздела 2	55
3 Экспериментальное определение тепловых и механических свойств	
образцов кармических коммутационных плат	56
3.1 Прочность	56
3.2 Коэффициент Пуассона	59
3.3 Усталость	60
3.4 Теплопроводность и теплоемкость	62
Выводы раздела 3	65
Заключение	66
Список использованных источников.	68

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития информационных технологий требует от разработчиков радиоэлектронных и радиотехнических средств контроля в первую очередь решения проблем повышения их быстродействия, энергетического и информационного доступа в условиях резко усложнившейся радио обстановки.

Решение этой проблемы традиционными методами исчерпало свои возможности и показало необходимость поиска новых подходов при разработке и производстве сложных технических систем передачи, приема и обработки больших потоков информации.

Технология LTCC (Low - TemperatureCofireCeramic) эффективна при решении проблем развития систем на базе аналоговых, аналого-цифровых и цифровых ФАР. Технология LTCC широко развита в мировой практике, однако не имеет аналогов в Российской Федерации.

Перспективность технологии LTCC основана на том, что она становится технологией создания единого конструктива больших трехмерных радиоэлектронных модулей, объединяя в нем большое количество различных низкочастотных, высокочастотных и СВЧ элементов и узлов.

Наряду с улучшением массогабаритных характеристик создаваемых технических средств и их надежности это позволяет резко повысить и другие ТТХ за счет уменьшения общей компоновки изделия и сокращения меж соединений в многослойных трехмерных конструкциях. В аппаратуре формирования и обработки информационных сигналов тактовые частоты перспективной аппаратуры в ближайшее время уходят в СВЧ-диапазон. Это требует нового подхода к технологии формирования цифровых цепей, т.к. они становятся СВЧ трактами.

Технология печатных плат не позволяет создавать такого уровня коммутационные цепи (низкие СВЧ свойства применяемых материалов, низкое для данного диапазона частот разрешение технологии).

Технология LTCC, как по свойствам применяемых материалов, так и по точности разрешения элементов топологии обеспечивает перспективные требования для цифровой аппаратуры на ближайшее десятилетие [1].

Изъяты главы с 1 по 3 со страницы 7 по 65 включительно, изъята таблица 17 из заключения со страницы 66 согласно приложению Б Регламента о размещении ВКР СФУ, 2016 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология LTCC позволяет создавать принципиально новые трехмерные гибридно-монолитные конструкции приемо-передающих устройств и модулей аналого-цифровых ФАР, позволяющие осуществить интеграцию в составе единого модуля многослойных СВЧ узлов и устройств цифровой обработки с интегрированными цифровыми СБИС (в т.ч. «система на кристалле»), СВЧ МИС, элементами оптоэлектроники и акустоэлектроники.

Технология LTCC базируется на технологии толстопленочных ГИС и многослойных печатных плат. Широкое распространение получила при создании РЭА за рубежом. В отечественной практике находится в стадии освоения.

Основой технологии LTCC является комплекс материалов, включающий «сырую» керамику (термин для необожженной ленты GreenTapeTM, DuPont) в качестве несущего диэлектрического основания слоев и согласованную по усадке керамики при совместном обжиге систему паст для формирования пассивных элементов (проводников, резисторов, конденсаторов, индуктивностей). Отечественные материалы отсутствуют. Анализ показал, что для реализации поставленной задачи наиболее перспективными являются материалы фирм «DuPont».

Специальное технологическое оборудование отечественного производства практически отсутствует. Ведущими зарубежными фирмами по производству СТО для технологии LTCСяляются «Baccini», «AMIPresco», «DEK», «BTU», «PacificTrineticsCorporation», «KEKO Equipment», «EKRA», «Aurel» и др.

Основными технологическими ограничениями при создании модулей по технологии LTCC, исходя из возможностей имеющегося оборудования и степени освоения технологии являются:

- количество слоев не выше 40;
- максимальный размер заготовки 127 х 127 мм. (5 х 5 дюймов);
- максимальный размер платы не более 100х100 мм.;
- минимальная ширина проводников 50 мкм;
- минимальный зазор между проводниками 50 мкм;
- допуск резисторов внутренних слоев $\pm 20 \%$;
- допуск резисторов наружных слоев ± 1 %.
- минимальный диаметр переходного отверстия 100 мкм.

Частотный диапазон устройств на основе технологии LTCC зависит от характеристик исходных материалов. Так «951 GreenTape TM system» фирмы «DuPont» предназначена для диапазона частот до 20 ГГц, а «943 GreenTape TM system (lowloss)» до 40 ГГц.

Министерство науки и высшего образования РФ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Политехнический институт институт

Межинститутская базовая кафедра «Прикладная физика и космические технологии» кафедра

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой

А. В. Кузовников инициалы, фамилия

2024г

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

«Разработка новой технологии определения характеристик керамических плат низкотемпературного отжига»

15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»

код и наименование направления

15.04.05.02 «Технологии производства космических аппаратов» код и наименование магистерской программы

Руководитель

Выпускник

эдпись, дата

подпись, дата

доцент МБК ПФиКТ канд. физ-мат. наук

должность, ученая степень

А.А. Хвалько инициалы, фамилия

А.А. Гераськина

инициалы, фамидия

Рецензен

подпись, дата

ведущий инженерконструктор отдела 640

АО «РЕШЕТНЁВ» должность, ученая степень

В.Б. Гарданов инициалы, фамилия

Нормоконтролёр

дрофессор МБК ПФиКТ д-р техн. наук, доцент

должность, ученая степень подпись, дата

В.Е. Чеботарев инициалы, фамилия

Красноярск 2024